

北京君正集成电路股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年11月23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2021年11月17日以通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，同意公司及子公司与华夏银行股份有限公司天津分行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司合肥分行分别签订《募集资金三方监管协议》。其中，“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”实施主体为矽恩微电子（厦门）有限公司，公司将先增资公司全资子公司北京矽成半导体有限公司，然后通过其再拨付给下属子公司矽恩微电子（厦门）有限公司。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日